

事業計画及び 成長可能性に関する事項

株式会社TMH（280A）

2024年12月4日

AGENDA

- | | | |
|-----------|----------|-----|
| 01 | 会社概要 | P 3 |
| 02 | 事業内容 | P11 |
| 03 | 市場環境 | P21 |
| 04 | 競争優位性 | P28 |
| 05 | 成長戦略 | P35 |
| 06 | リスクと資金使途 | P44 |

01 会社概要

会社概要

会社名 株式会社TMH

代表取締役社長 榎並 大輔

所在地 大分県大分市下郡北3-14-6

設立 2012年3月9日

従業員数 37名 (2024年9月末時点)

資本金 1億円 (2024年9月末時点)

事業内容 半導体製造フィールドソリューション事業
(装置・部品の販売・修理、越境ECサイト
LAYLA-ECの運営)

事業所 大分本社・中部地区支社・関東地区支店・
東北出張所・九州支店 (熊本)

全国 **5拠点** に展開





株式会社TMHは、**T**echnology **M**akes **H**appinessの
頭文字から社名が構成されております。

先端技術で、
豊かな社会を創ること

会社紹介

当社は巨大な半導体市場において半導体工場の稼働を様々なかたちで支援するリーディングカンパニー



半導体業界が直面する様々な社会課題を解決する リーディングカンパニー

領域

巨大な
半導体業界

提供する価値

半導体製造装置の延命
メンテナンスコストの軽減

特徴

ニッチトップ
かつ
高成長

当社が必要とされる背景

老朽化した半導体工場には、多様なサプライチェーン課題が山積した状態

調達課題

- 日本の工場の多くは**陳腐化・老朽化が進み**、**レガシー半導体製造装置**が多く、**部品の調達が困難**
- レガシー半導体製造装置部品の調達は、属人的な調達手法が中心（**デジタル化の遅れ**）

製造課題

- IoT（Internet of Things）により急速な需要の高まりにより、**旧型装置の需要が継続**
- 長期的な国内半導体市場の低迷により、**エンジニア人材が枯渇**
- レガシー半導体工場では**設備保全の属人化が常態化**、装置トラブルが品質問題や大規模な納期遅延に発展

物流課題

- 部品取りのために購入した**旧型装置の保管が常態化**することで**生産スペースを圧迫**

当社が目指す未来

半導体製造に関する多様な課題を解決し、
日本のものづくりの復権を支えます

マネジメントチーム

半導体製造装置の専門家が不足するなか、半導体・サプライチェーンの専門家にて構成



榎並大輔 Taisuke Enami
代表取締役
CEO

早稲田大学卒業後、株式会社東芝に入社。
東芝在籍中にサプライヤー管理に課題を感じ独立。
創業以来連続増収を実現。
2020年には大分県から地域牽引企業として選定



香月賢一 Kenichi Katsuki
取締役 COO

株式会社東芝入社後、20年以上購買・調達に従事。2012年には東芝本社調達部の集約部材に配属。年間数十億円のコストダウンや改善を実現。2016年にTMHに参画



関真希 Maki Seki
取締役 CFO

大手事業会社、デロイト・トーマツコンサルティング社にて経営改革に従事。グローバルコスト構造の可視化、M&A等サプライチェーン観点から多数のプロジェクトに従事。2015年にTMHに参画



野木村修 Osamu Nogimura
社外取締役

名古屋大学卒業後、日立製作所に入社。
ルネサステクノロジ生産本部長、ルネサスエレクトロニクス執行役員
生産本部本部長、ルネサスセミコンダクターパッケージ&テストソリューションズ
代表取締役社長を歴任。一貫して半導体製造部門に従事

会社沿革

九州発の半導体製造Startupとして、各方面から信頼を蓄積し展開を加速

2012 3月 大分県大分市に株式会社TMHを設立

2014 9月 三重県四日市市に中部支店を新設

2016 4月 東京都港区に関東支店を新設
8月 中部支店を三重県四日市市内で移転

2018 4月 半導体製造装置・半導体製造装置部品に特化した越境EC「LAYLA-EC」稼働開始
10月 関東支店を東京都千代田区に移転

2019 5月 岩手県北上市に東北出張所を新設

2020 6月 大手半導体メーカーから
Regional Supplier Recognition Awardを受賞
10月 大分県地域牽引企業創出事業として
大分県知事より選定

2021 6月 関東支店を茨城県土浦市に移転

2022 3月 経済産業省九州経済産業局より
「J-Startup KYUSHU」企業に選出

2023 7月 越境EC「LAYLA」を拡張し、
「LAYLA-Auction」稼働開始
10月 関東支店を東京都港区に移転

2024 1月 九州支店を熊本県菊池市に新設

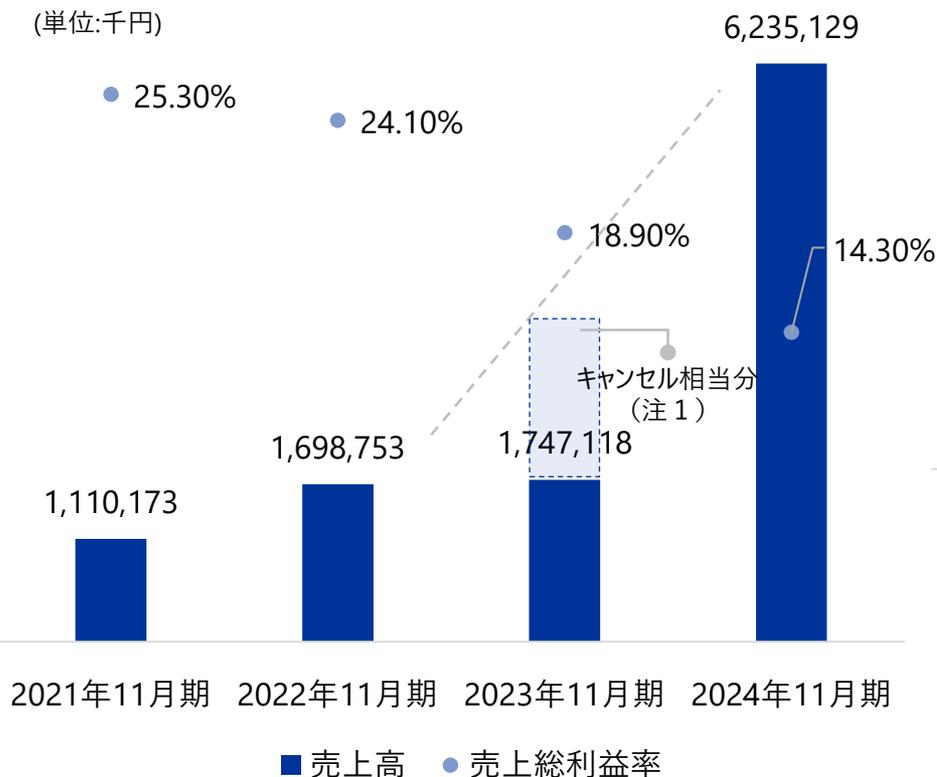
重要な経営指標

当社の掲げる重要な経営指標は以下の通り

- サービスラインナップの拡大により、継続増収を実現。当社の属する半導体製造アフターマーケットのシェアを拡大
- 長期的にはサービスの差別化により、収益性を高める努力を継続

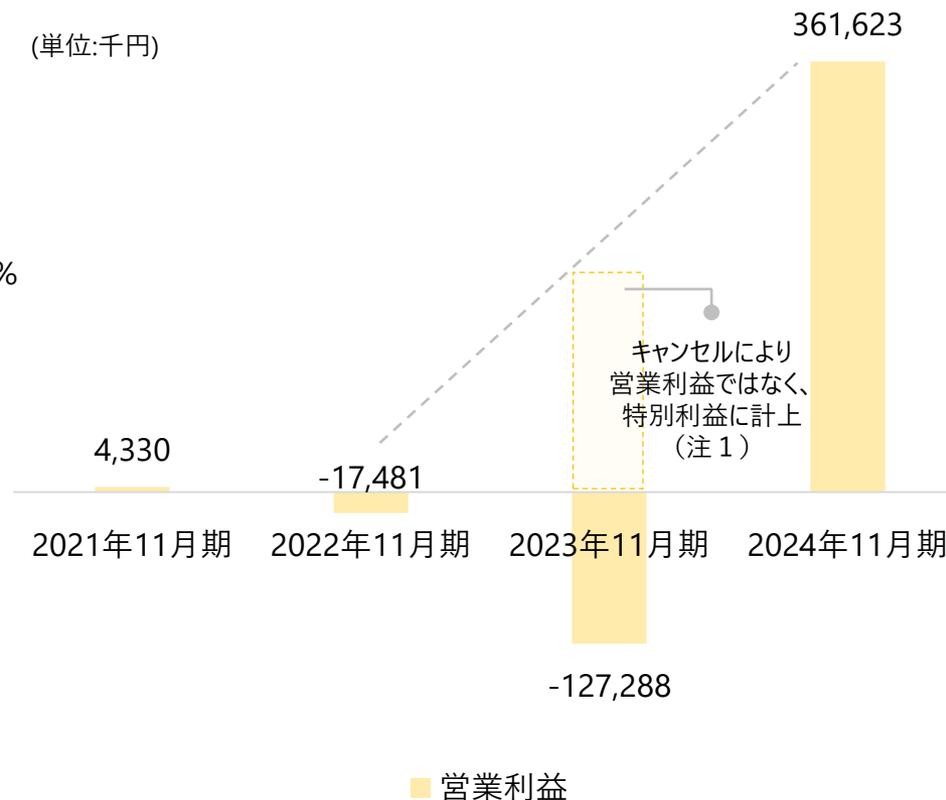
売上高・売上総利益率推移

(単位:千円)



営業利益推移

(単位:千円)



(注1) 2023年11月期は、全体で26.7億円の売上を計画しておりましたが、受注後の大型案件のキャンセルがあり、売上としては前年対比では2.8%増に留まりました。一方で、受注後キャンセルに伴う受取補償金により、当期純利益は1.1億円の黒字となっております。本来であれば、売上に貢献すべき案件であったため、上記グラフにおいては、わかりやすさを考慮して、受取補償金ではなく売上として計上された場合におけるイメージを点線棒グラフにて追加させていただいております。

02 事業内容

事業内容 ～半導体製造フィールドソリューション事業の概要～ トータルソリューションの提供により、半導体工場の稼働を支援

半導体工場へのトータルソリューションサービスを提供

① 越境ECプラットフォーム等を利用した部品販売・修理サービス

世界中の半導体製造装置・部品の売買にプラットフォームを活用



【サービス内容】

- ✓ 希少部品の供給
- ✓ 幅広い修理サービスの提供

【実績】

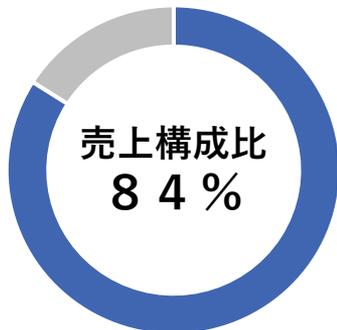
- ✓ 200社超の優良なグローバルサプライヤー（多種多様なメンテナンスや部品供給）
- ✓ 31.5万点超のアイテム数、50%超の国内半導体工場が導入済み



2024年度見込み

② エンジニアリング力を活用した装置販売サービス

装置解体、移設、搬出、プロセスチューニング、立上げサービスを提供



【サービス内容】

- ✓ 専門性が必要な装置の解体から搬出まで一気通貫でのサービス提供
- ✓ 旧型装置のプロセスチューニングによる歩留まりの改善

【実績】

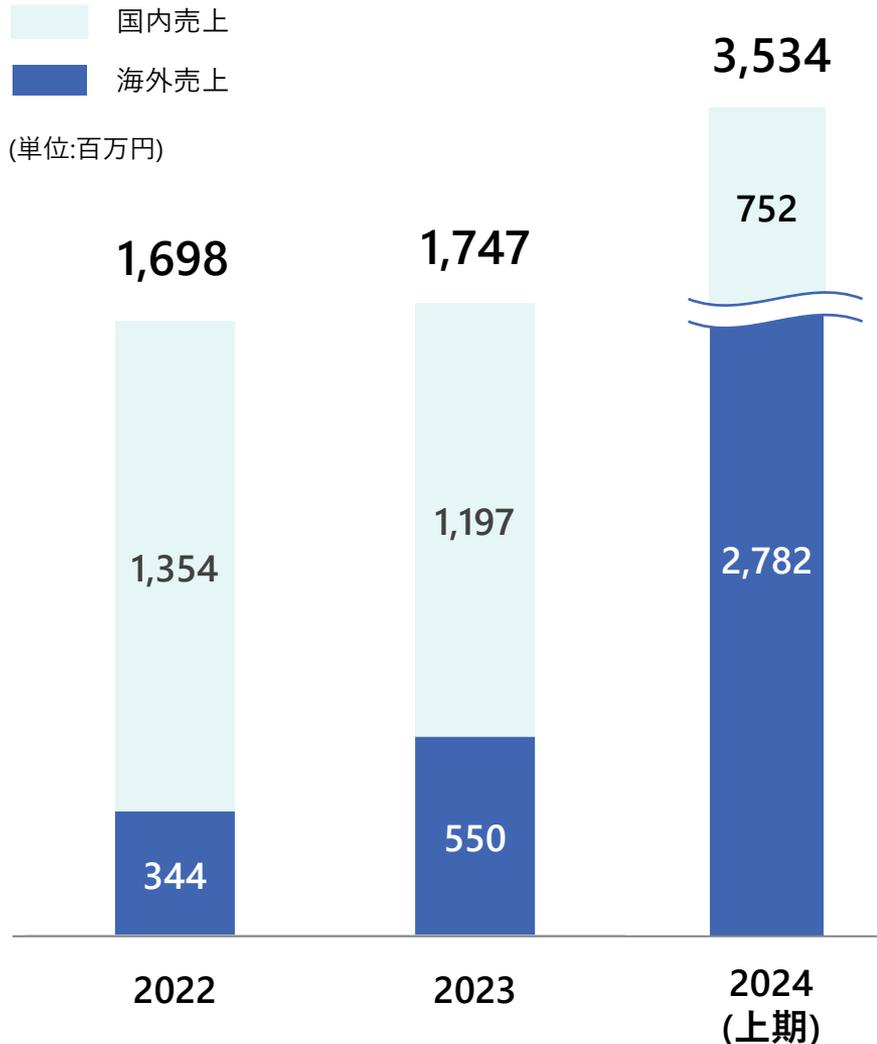
- ✓ 大手米国半導体メーカーからサプライヤーアワード受賞
- ✓ 過去の実績を持つ信頼性（半導体製造装置の取引、100台超）



2024年度見込み

事業内容 ～半導体製造フィールドソリューション事業の海外売上高推移～ トータルソリューションの提供により、海外売上高も順調に推移

海外売上高の推移



海外展開の状況

エンジニアリング力を活用した装置販売により、海外売上高比率が拡大

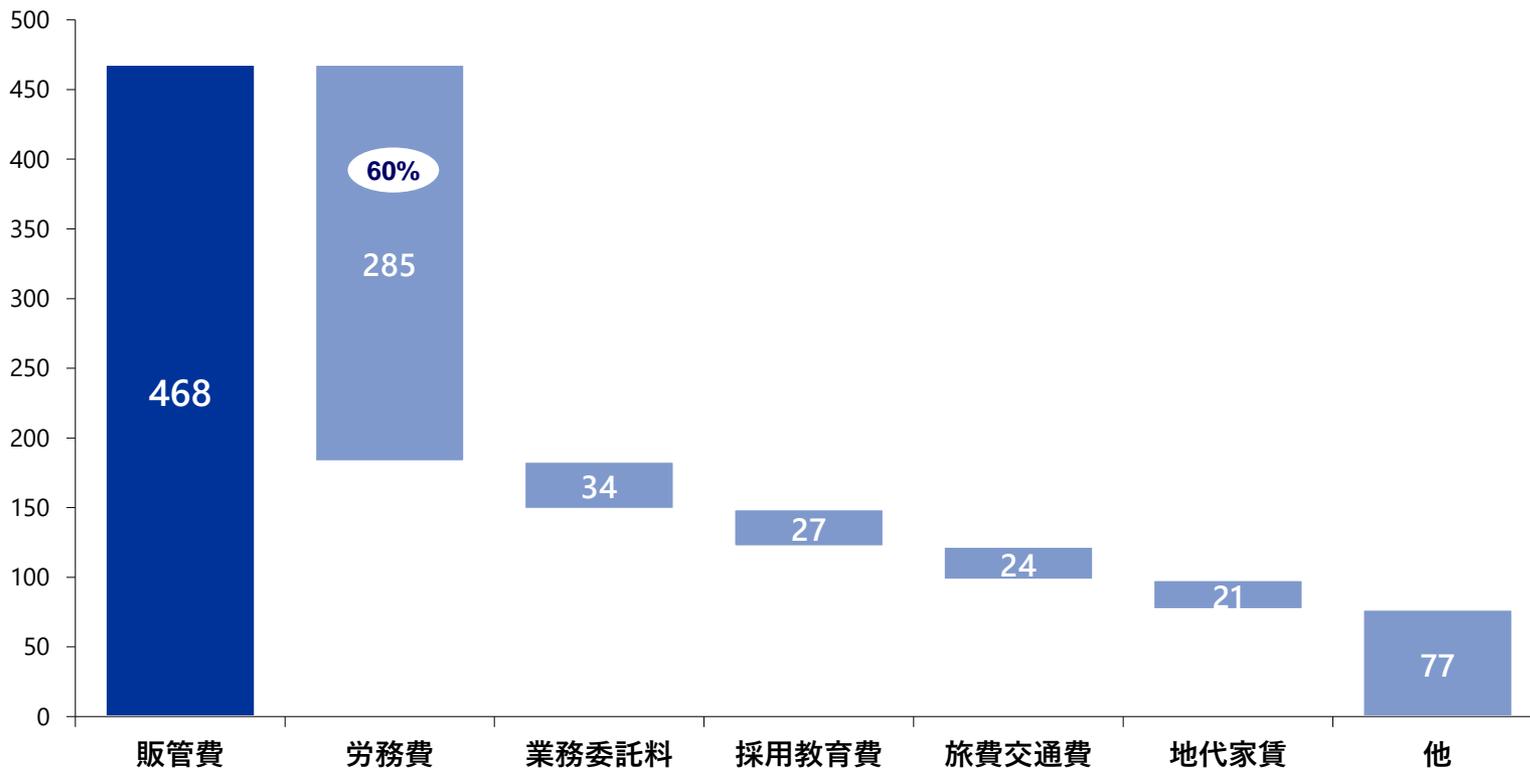
- 当社は創業当初、国内の半導体工場向けに部品販売や修理サービスを提供しておりましたが、事業およびサービス領域の拡大に伴い、海外売上高比率が増加しております。
- 部品販売や修理サービスは地理的な制約から国内売上が大半を占めています。一方で、半導体製造装置の販売については、国内外を問わず案件の獲得を目指しておりますが、2024年11月期においては海外販売の割合が大きく増加致しました。

事業内容 ～半導体製造フィールドソリューション事業の費用内訳～

販管費の主要な費用は、労務費で構成されており、人材への投資が当社の強みへとつながっている

販売費及び一般管理費の主要な支出項目

単位：百万円



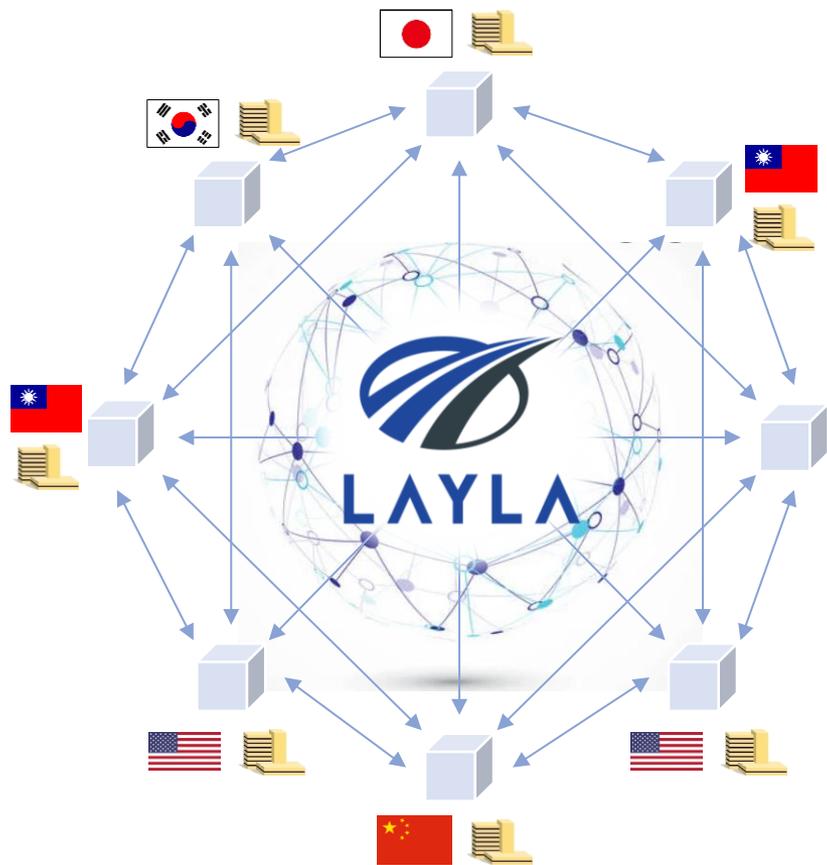
販管費内訳

出所：23年11月期、販管費実績

① 越境ECプラットフォーム等を利用した部品販売・修理サービス オンライン(EC)とオフライン(商社機能)を融合させ、工場が部品をシームレスに購入できる仕組みを実現

サプライヤー**200**社超がLAYLA-ECに登録

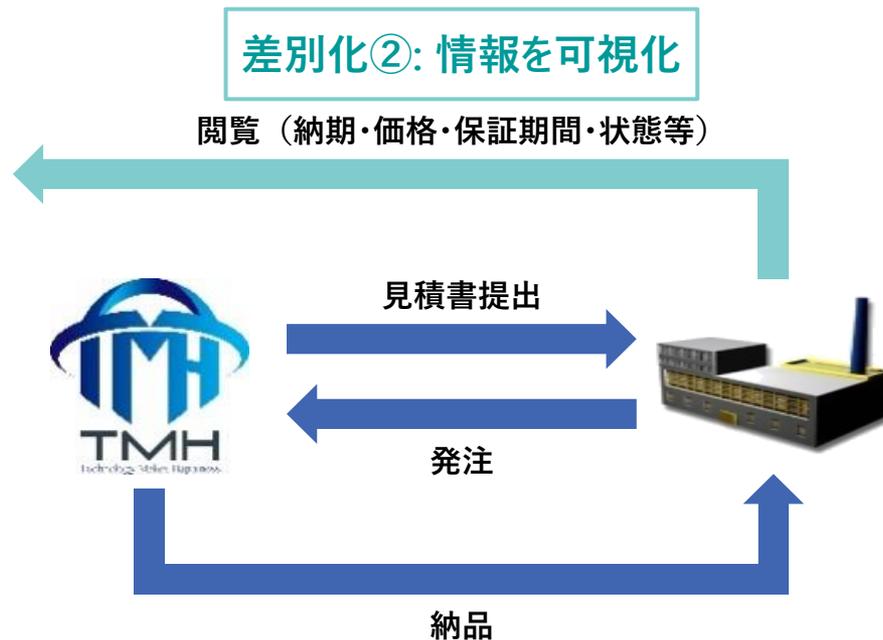
商品数**31.5**万点超



差別化①: 点在している部品を集約

差別化②: 情報を可視化

閲覧 (納期・価格・保証期間・状態等)



差別化③: 安心保証

オンラインサービス (EC)

オフラインサービス (商社機能)

当社での調達・販売はLAYLA-EC経由以外にも対応しており、半導体製造装置・部品の商社機能も重要な役割をになっております。

② エンジニアリング力を活用した装置販売ビジネス

社内FEチームや優良なサプライヤーとの協業により、半導体製造装置の解体、搬出、設置も可能



ライフタイムの延命とは、メンテナンス等により製品の使用寿命を延ばすための一連の活動や手段のこと
スループットの向上とは、装置が単位時間あたりに処理できる作業量やデータ量を増加させること

ビジネスフロー

ECプラットフォームとエンジニアリングを融合し、半導体工場の持続的な稼働を支援

- 世界中のエンジニアリング会社やサプライヤーと協業し、部品の修理や販売、歩留まりの改善、不要装置・部品の買取など、お客様の課題に対して幅広いソリューションを提供
- LAYLAでは世界中の装置・部品のデータを集積し、半導体製造装置の調達プロセスを効率化
半導体工場における半導体製造装置の効率的な運用と持続可能性に貢献



ビジネスフロー 装置売買プロセス

装置売買の前提となる解体作業ノウハウが当社にあることが売買加速に



調達



物流



販売

入札

売買契約

解体

輸出

検収

請求

無害化

シャットダウン

ケーブル・配管
取り外し

内部コンポーネ
ントの解体

廃棄・分別

テクニカル
レポート

無害化

ガスラインの遮断と排除
冷却液や他の流体の安全な排除

シャットダウン

装置からの電源切断
バックアップバッテリーの除去

ケーブル・配管取り外し

外部カバーの取り外し
配管やケーブルの取り外し
内部コンポーネントの解体
モジュールや部品の個別の取り外し

廃棄・分別

再利用可能材料の分別
有害物質の適切な処理
リサイクル廃材の適切な処分

テクニカルレポート

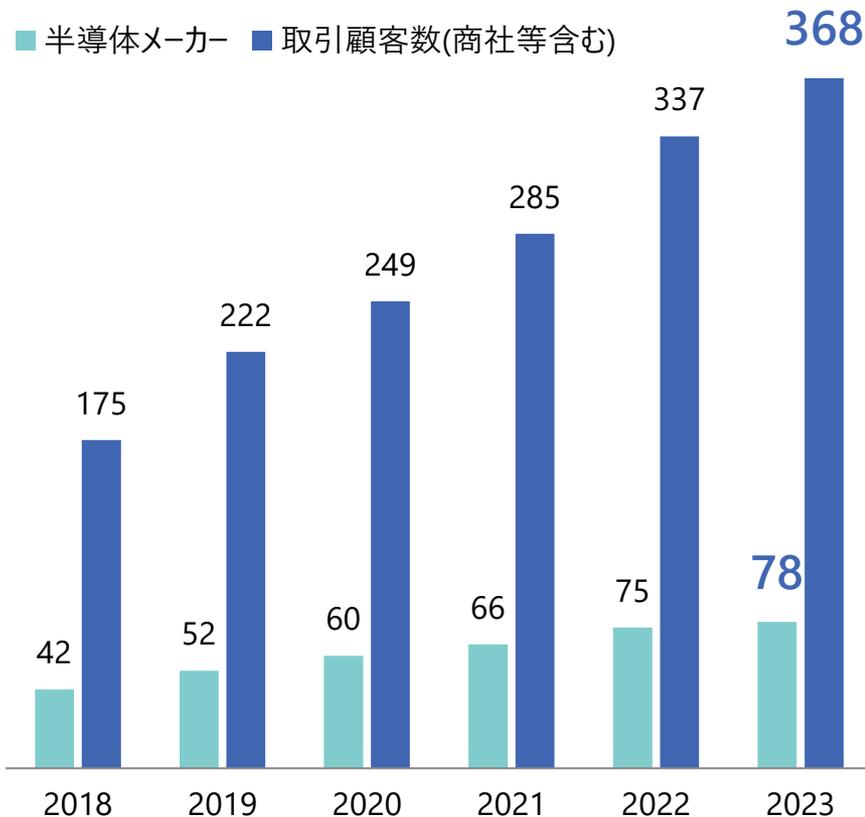
作業の詳細な記録
インシデント報告

顧客

越境ECサイトを活用した圧倒的な調達力により、国内の半導体メーカーとの直接取引を拡大

- 顧客数は半導体メーカー（拠点数）で70拠点数超。その他顧客も含めて全ての取引顧客数で300社超
- 国内ほぼすべての半導体メーカーと直接取引
- 越境ECサイト「LAYLA-EC」の展開も加わり、海外半導体メーカーとの取引も拡大し売上拡大に寄与

顧客数推移



2023年度11月実績

国別クライアントマップ

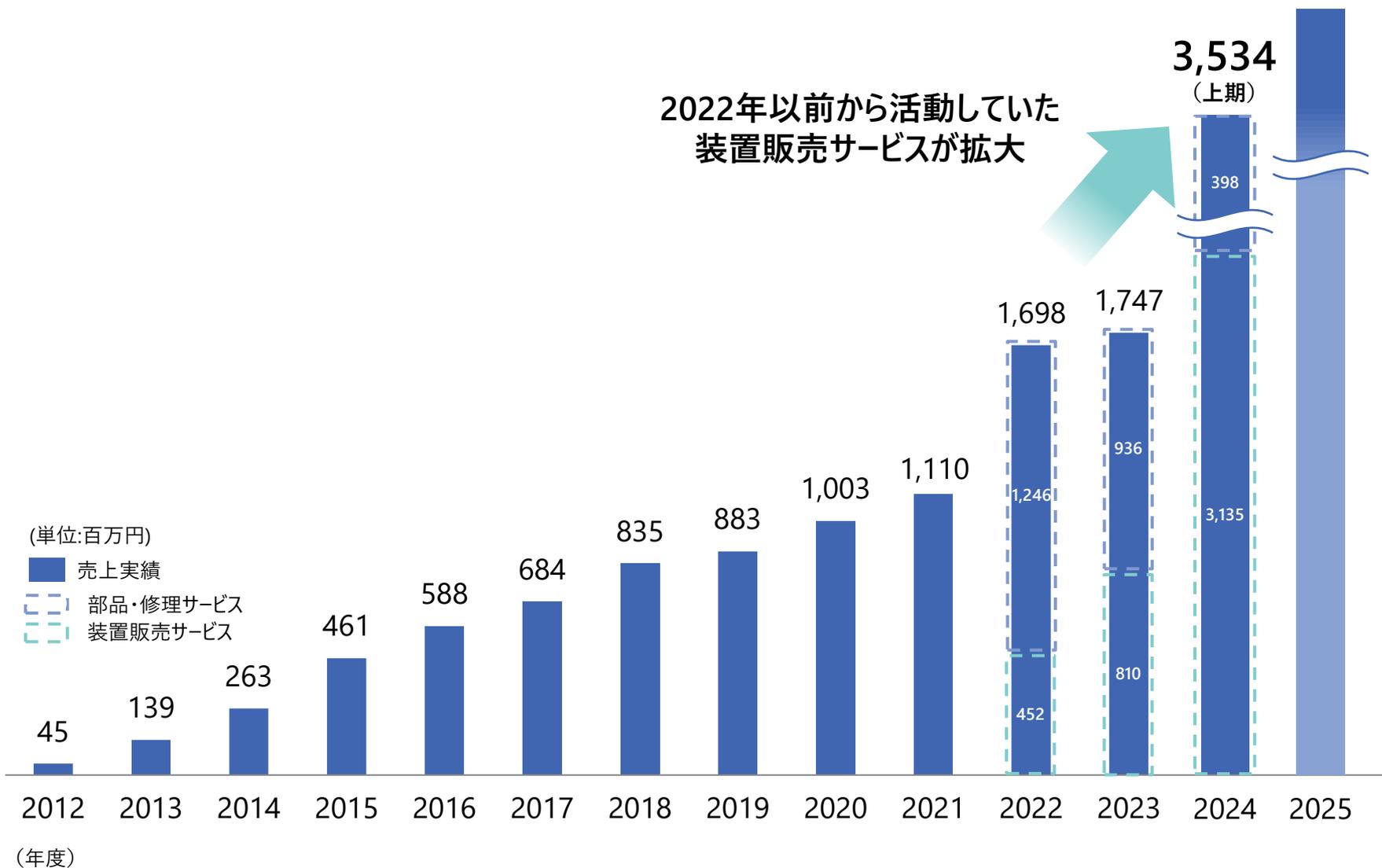


取引実績

- キオクシア
- テキサスインスツルメンツ
- ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
- ルネサスエレクトロニクス
- SUMCOグループ
- 東芝グループ
- ラピス 他

業績推移

プラットフォーム（情報力）とエンジニアリングの強みを融合し、事業は創業以来増収継続



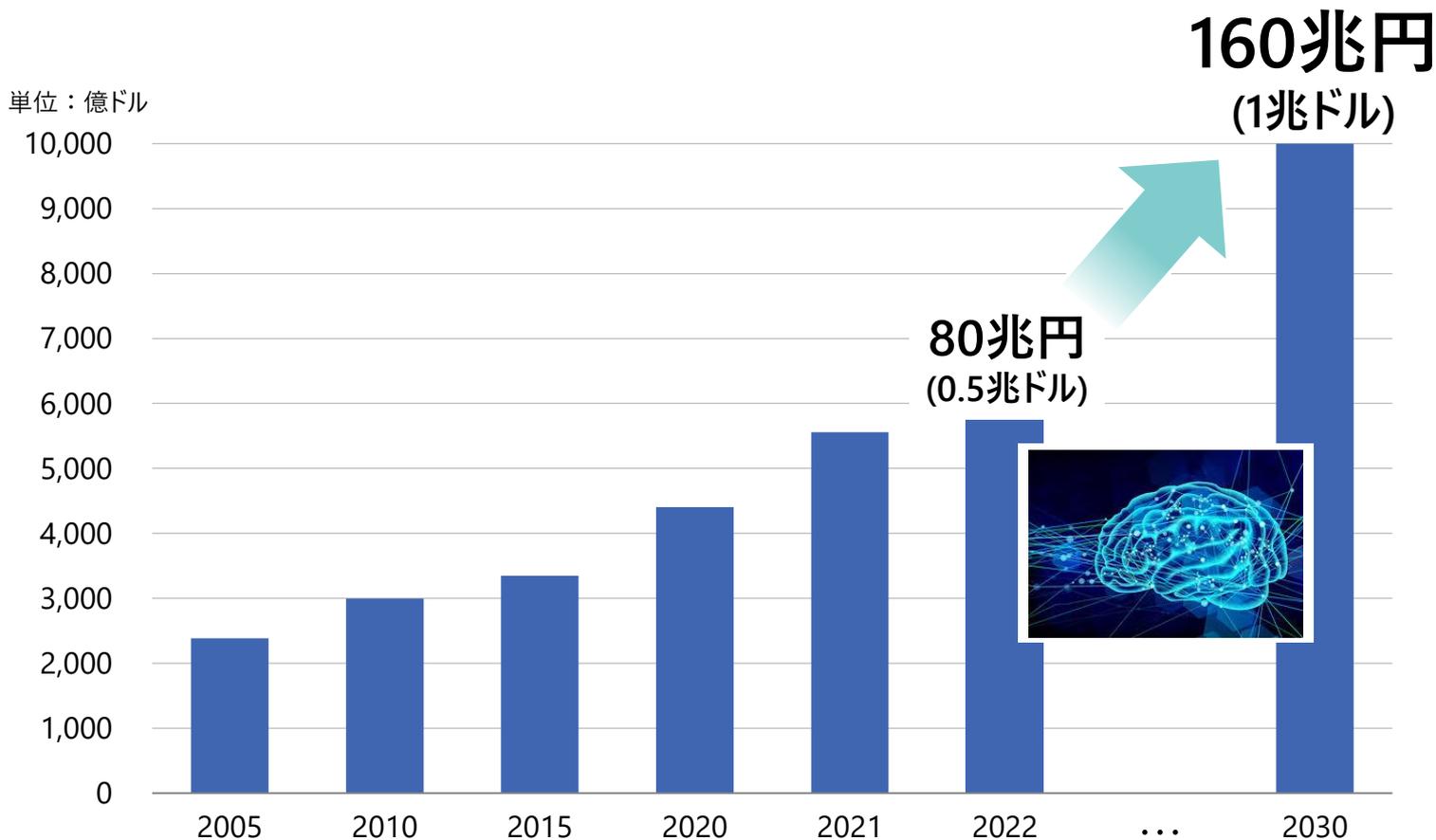
03 市場環境

世界の半導体市場規模

2030年には全世界の市場規模が160兆円にも成長することが見込まれている

- AI、5G、電気自動車、量子コンピュータ、あらゆるテクノロジーに半導体は使われており、半導体の用途は多様化し、近年市場が急激に拡大

世界の半導体市場予測



出所：SEMI, May 9, 2022 ISS 2022: Semiconductor Industry Market Outlook and Prospects for Reaching \$1 Trillion by 2030
経済産業省（2021.3.24）「第1回半導体・デジタル産業戦略検討会議」、WSTS 2024年春季半導体市場予測

当社の事業背景 ～世界市場における旧型半導体製造装置の重要性～ 「最先端装置」だけでなく、多様な用途に適応する「旧型装置」の需要も高い

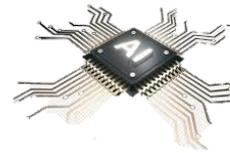
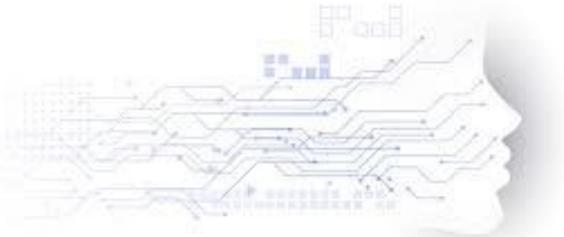
半導体市場の現状

半導体市場の投資動向 (対応の方向性)

最先端

AIや最新テクノロジーの進歩により、高性能な最先端半導体が必要とされ、半導体の進歩なしでは文明の進歩もないという状況

官民協力で、先端半導体開発に数兆円規模の投資が進んでいる（Chips法、経産省補助金、TSMC投資など）



旧型

IoT製品や電気自動車などの消費者に身近な製品が普及し、半導体の用途が多様化。
低～中程度の性能の半導体の需要も旺盛。
20年以上前に投資された半導体製造装置も現役で稼働している状態である

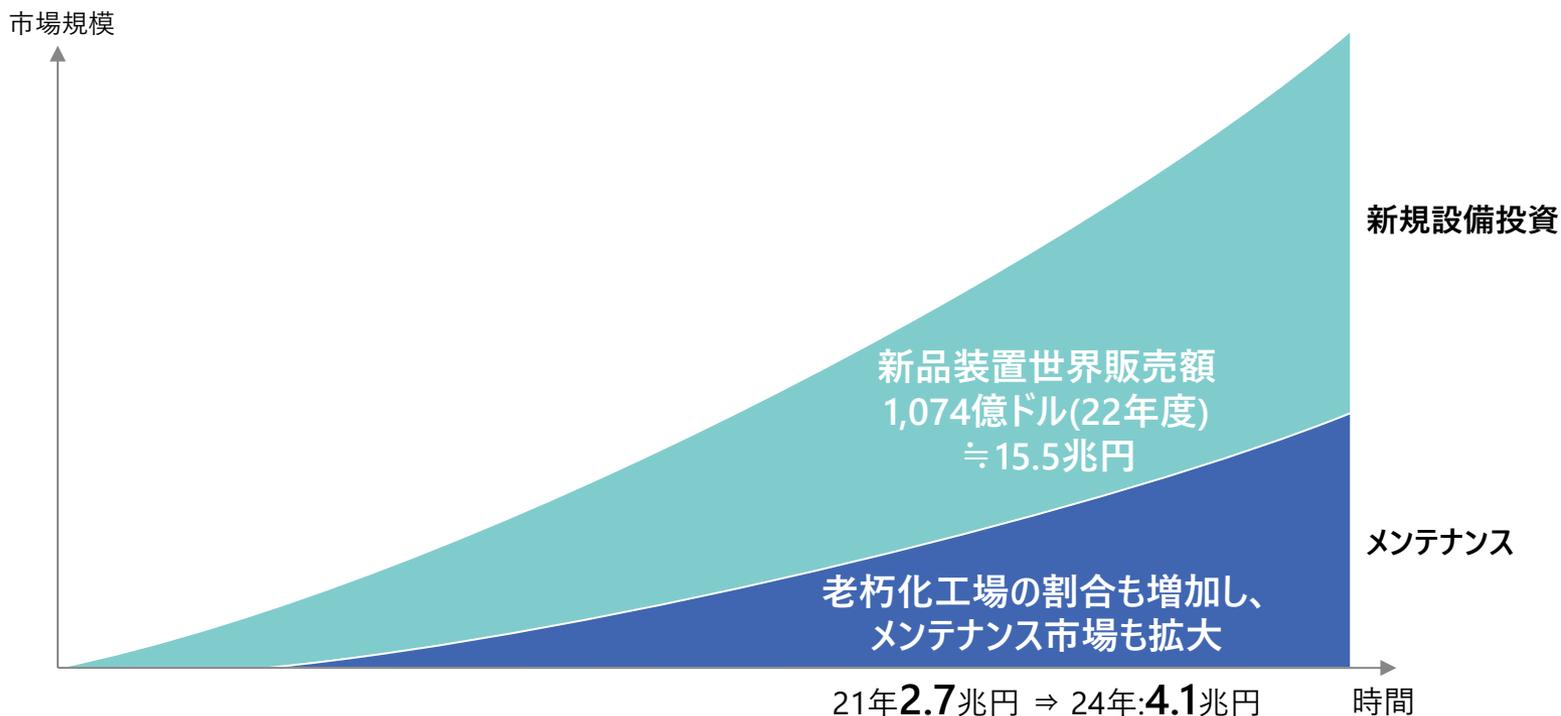
旧型半導体製造装置は現在も重要性が高く、装置の保守（EOL部品の調達、修理、中古装置の購入や立上・改善など）に対する投資がグローバルでなされている

旧型半導体製造装置の保守は、最先端半導体開発と同様に重要なテーマである

当社の事業背景 ～メンテナンス市場（部品購入・修理等の保守）の拡大～ 新品・中古製造装置の増加とともに、装置を稼働させるためのメンテナンス需要も拡大

- シリコンサイクルと言われる半導体業界の構造的な景気変動サイクルにより、投資に凸凹があるが、一方で世界の累積工場数は増え続けており、アフターマーケットは拡大し、半導体市場が拡大するなかで、部品の調達が困難に

新品装置とメンテナンス



部品情報を集約した越境ECサイトとエンジニアリング力の両方が
社会に必要とされており、両方を満たせるのが当社の強み

(出所) メンテナンス（アフターサービス）の市場規模は、SEMI-NET, 半導体製造装置・ポストセールス市場年鑑より参照

国内半導体工場の現状 半導体工場の新旧比較

国内半導体工場の大半が20年以上前に建てられた200mm以下の工場である

出所：半導体工場ハンドブック2022に基づき作成
前工程 デバイスメーカー拠点単位での集計となります。

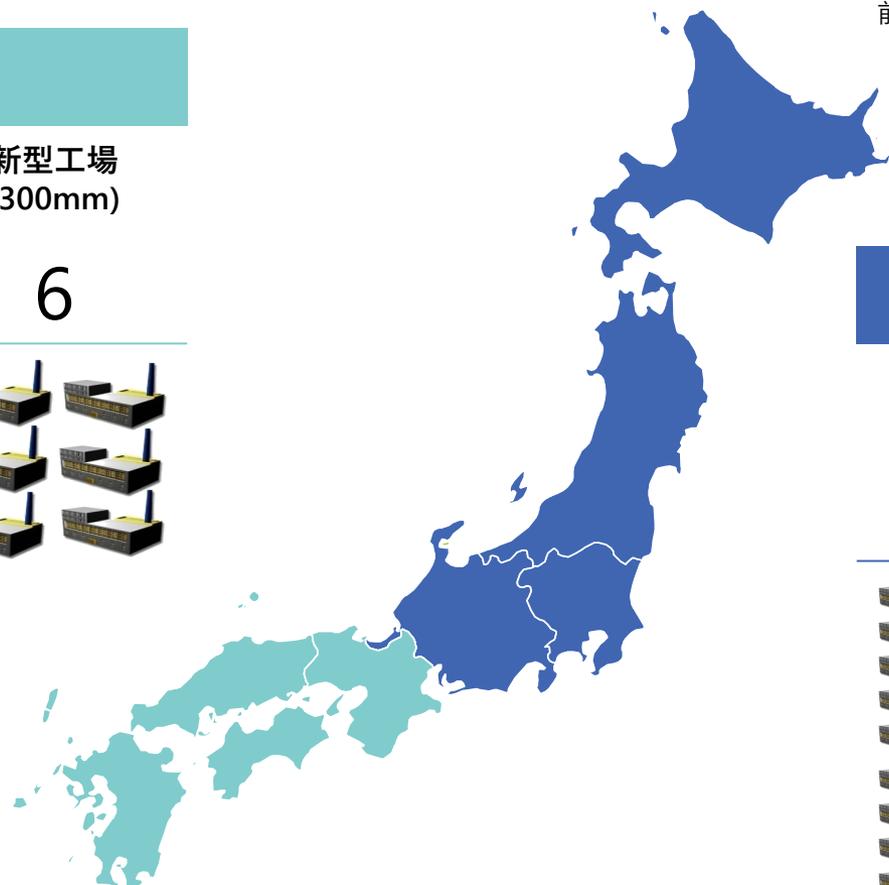
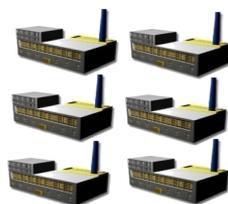
西日本

老朽化工場
(200mm以下)

新型工場
(300mm)

30

6



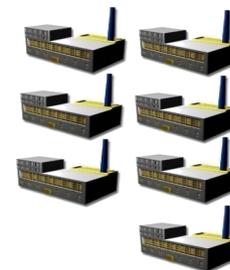
東日本

老朽化工場
(200mm以下)

新型工場
(300mm)

42

7



< 200mm / 300mmウエハサイズ工場について >

ミリとは、半導体チップを製造する材料であるウエハの直径サイズを意味しております。
200mmウエハは、過去に広く使われてきた標準的なサイズですが、現在では生産効率の高いより大きな300mmのウエハが主流になっております。200mmウエハを使っている工場は、古い技術を使っていることが多く、レガシー工場と呼ばれることがあります。

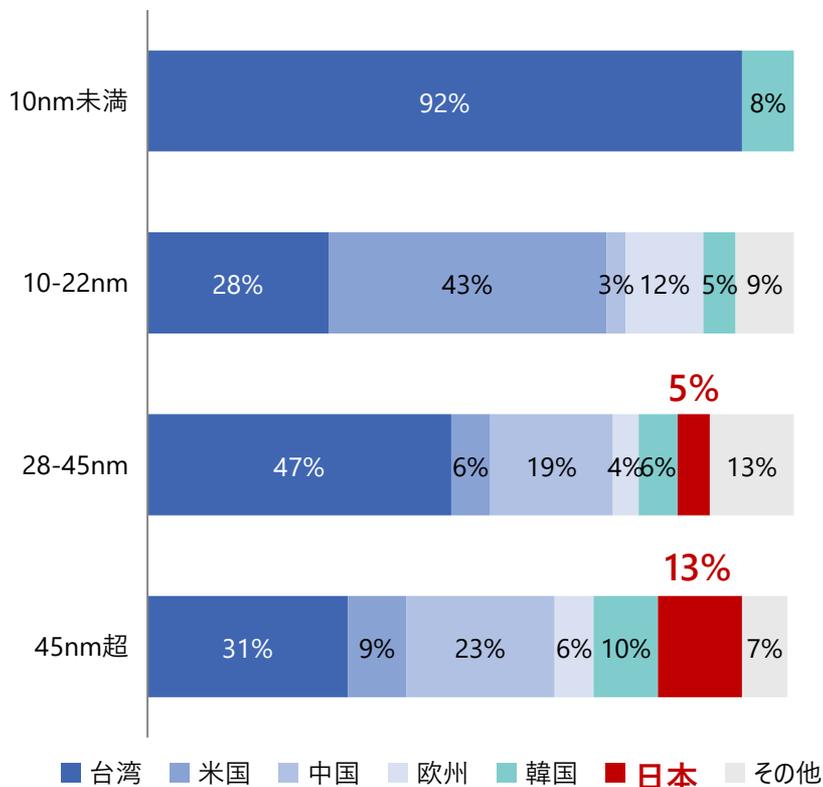
国内半導体工場の現状 旧型工場の日本における重要性

かつて世界一を誇った日本の半導体設備は現役で稼働しており、延命が求められている

- 世界では、微細化が進んでいる一方、国内では22nm以下の先端半導体の製造能力を有していない
- 日本の半導体シェアは衰退を続けているものの、半導体工場数では世界最大の工場数を保有

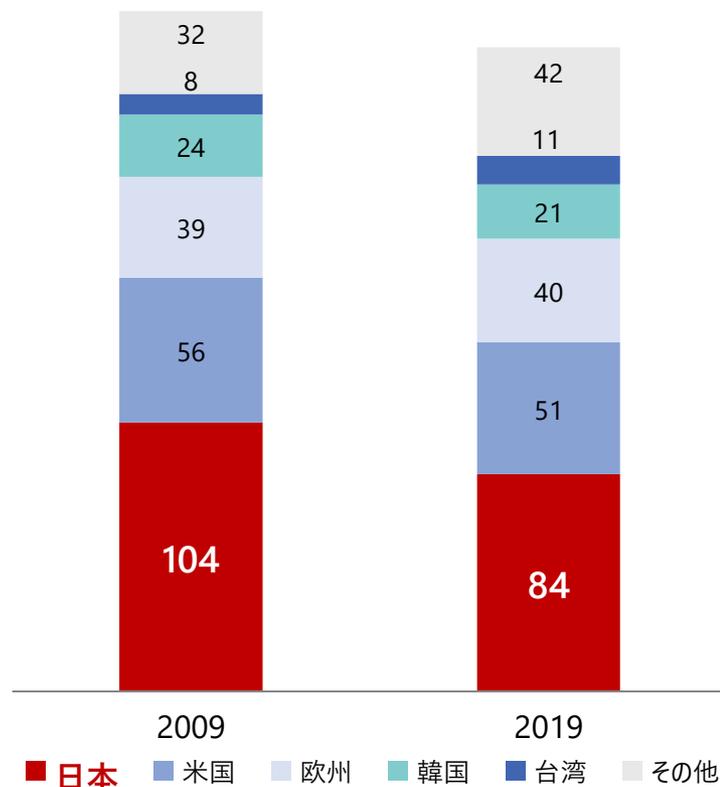
サイズ別半導体製造能力の国際比較

(出所) 内閣官房 成長戦略会議2021.4.12資料



世界の半導体工場の推移

(出所) 成長戦略実行計画(令和3年6月18日)



<ナノ (n) とは>

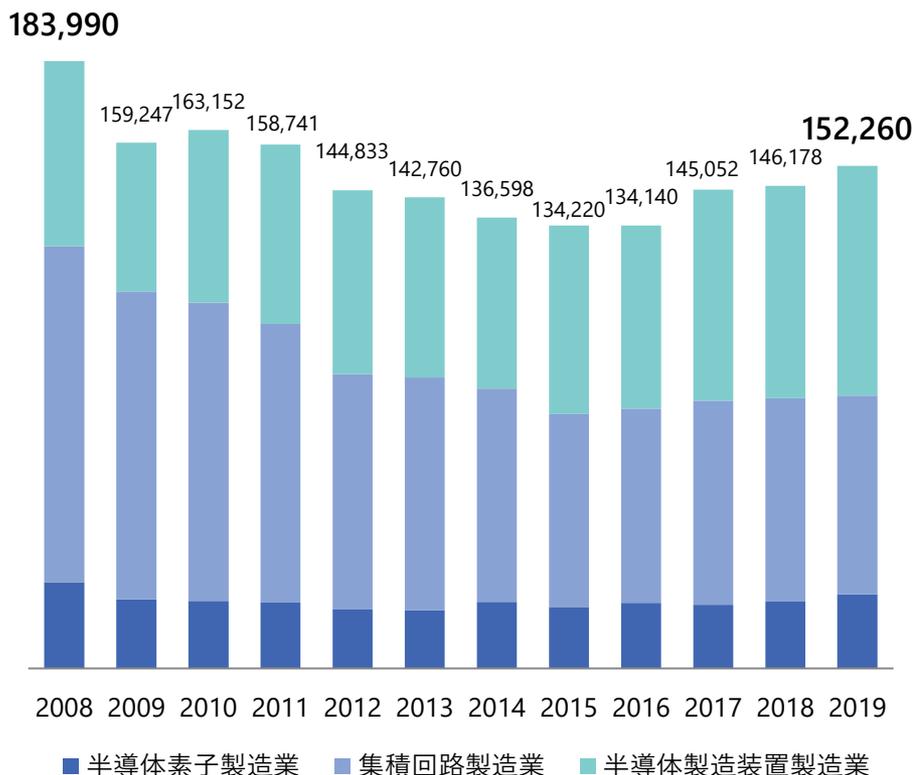
半導体をどれだけ微細に製造しているかを示す言葉であり、小さければ小さいほど高い技術が必要となります。最新世代は、5~3ナノメートルといった非常に小さな線幅が求められ、高精度な製造装置が必要となります。

国内半導体工場の現状 半導体業界の人手不足

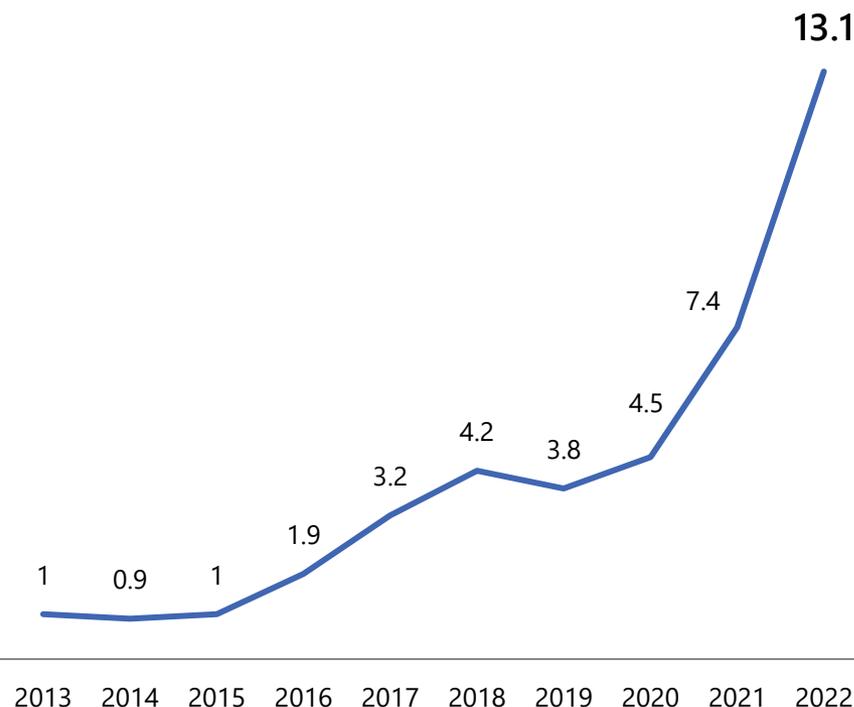
半導体業界は深刻な人手不足

- 工業統計調査(経済産業省)によれば、2008年に約18万人だった半導体は2019年には約15万人に迄減少
- その一方、半導体人材の需要は急速に伸びており、2022年は2013年比で13.1倍まで需要が加速
- TSMC（熊本）、ラピダス（北海道）、マイクロン（広島）など国内投資が加速

日本の半導体人材数



半導体関連のエンジニア求人倍率



(出所) 経済産業省「経済センサス活動調査・工業統計調査_2-01_産業細分類別_年次 2005年 - 2020年」を基に当社作成

04 競争優位性



1

プラットフォーム力 (情報力)

越境EC「LAYLA-EC」
全世界のサプライヤー
の在庫を可視化
(中古市場への強み)

グローバル部品調達経路
を確立、価格適正化に
貢献

急速に拡大する 強固な顧客基盤

ほぼすべての国内半導体
メーカーとの直接口座

米国大手半導体メーカー
からのSupplier award



2

エンジニアリング力

社内の半導体プロ集団
中古装置(解体～搬出)
一気通貫サポート

世界中の優良な
エンジニアリング会社と
協業による高い
技術品質の提供

当社の価値源泉

①プラットフォーム力及び②エンジニアリング力による製造支援にて価値創出を実現



従来のサプライチェーン課題

老朽化装置の部品不足

災害によるサプライチェーンの寸断

不要装置の処理

エンジニア等の人材不足

競争力の低下

半導体製造装置の老朽化

製造イノベーション

プラットフォーム力

- 装置・パーツ情報供給情報
- 半導体工場の需要情報
- 半導体製造周辺に関連する新規プラットフォーム構築力

エンジニアリング力

- 装置解体、搬出、設置
- 生産性改善提案
- プロセスチューニング

TMHの提供する価値

越境EC：調達ルート確保

部品の修理、調達

オークション：最適価格で売却

半導体人材プラットフォーム提供

装置解体/輸出

装置立上/改善

最終製品の機能改善

①エンジニアリング力 × ②プラットフォーム力により、顧客の様々な課題を解決

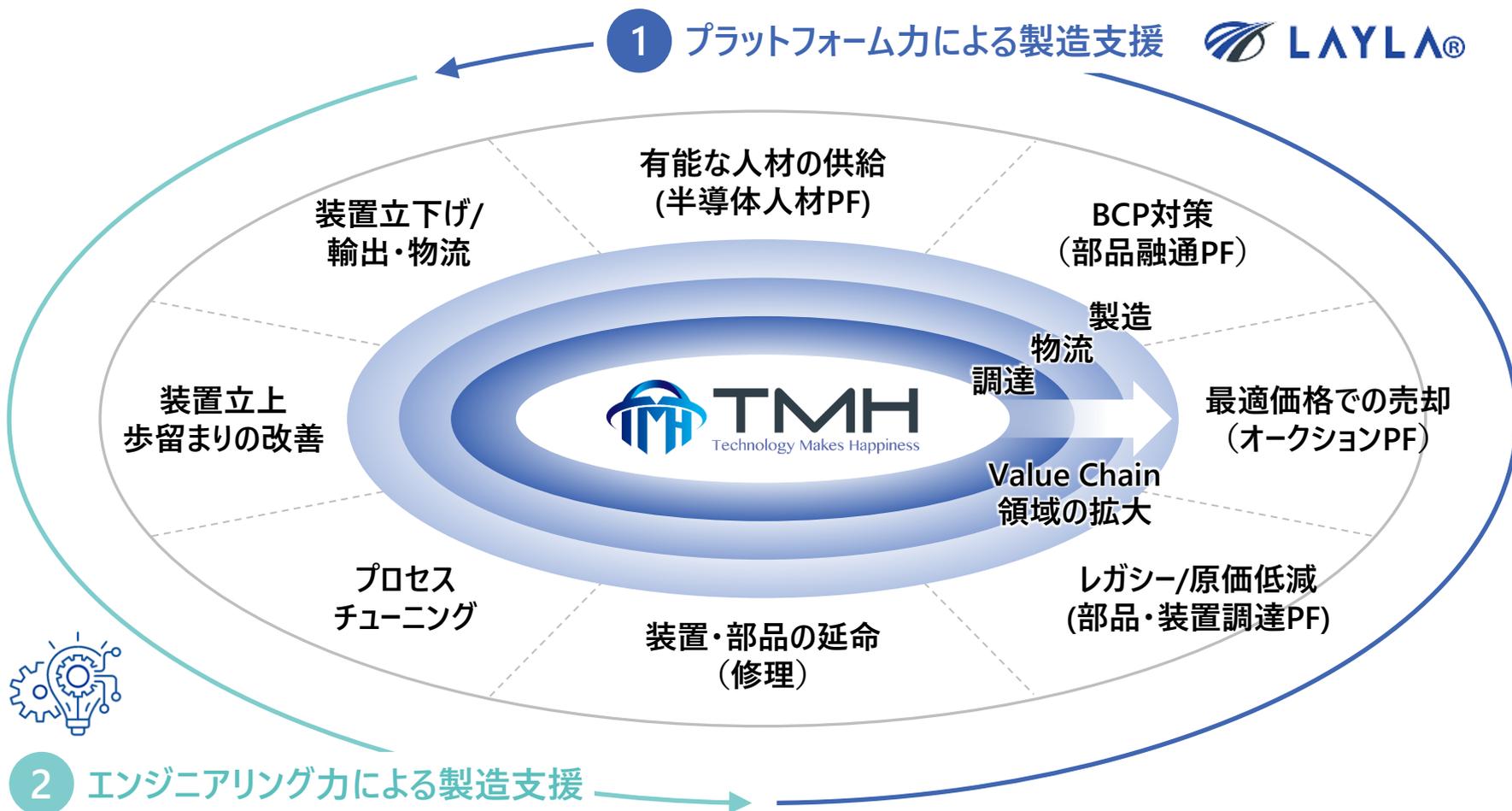
企業の収益向上と価値創出を実現

①×②=トータルソリューション力

半導体工場の多様な課題をプラットフォームとエンジニアリングの両面で解決

半導体工場の調達・物流・製造領域における課題を解決

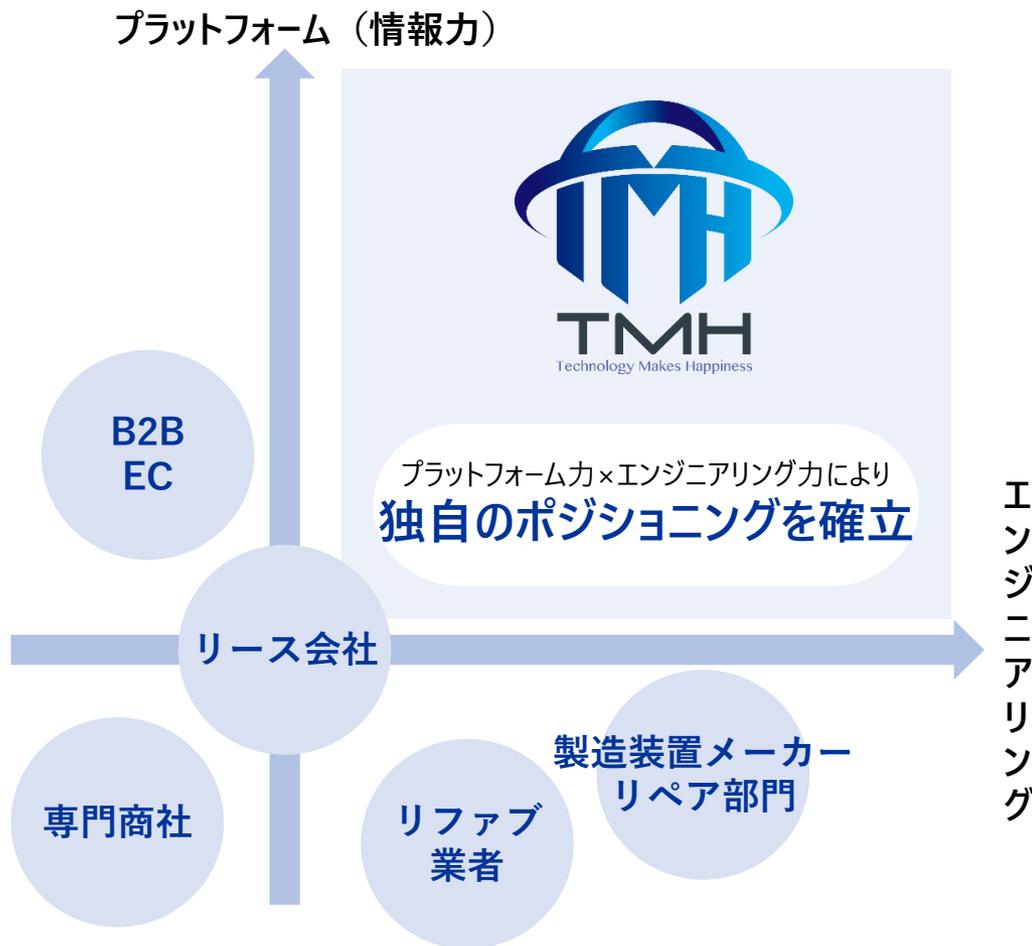
1 プラットフォーム力による製造支援



ポジショニングマップ

独自のポジショニングを確立し、ニッチトッププレイヤーとしての市場を創造

競合と当社の位置づけ



参入障壁

01 | vs リース会社、商社

- プラットフォームを活用したデジタルサービスを活用した情報力
- 半導体製造装置の立上げやプロセスチューニングといった高度な支援を提供

02 | vs 半導体製造装置メーカー

- 装置メーカーは先端工場に対して支援が厚いが、当社はレガシー工場も含めて広く半導体工場を支援
- 装置メーカーは自社製品のみ取り扱うが、当社は全ての製造装置メーカーの商材を扱い、幅広いサービスラインナップを提供

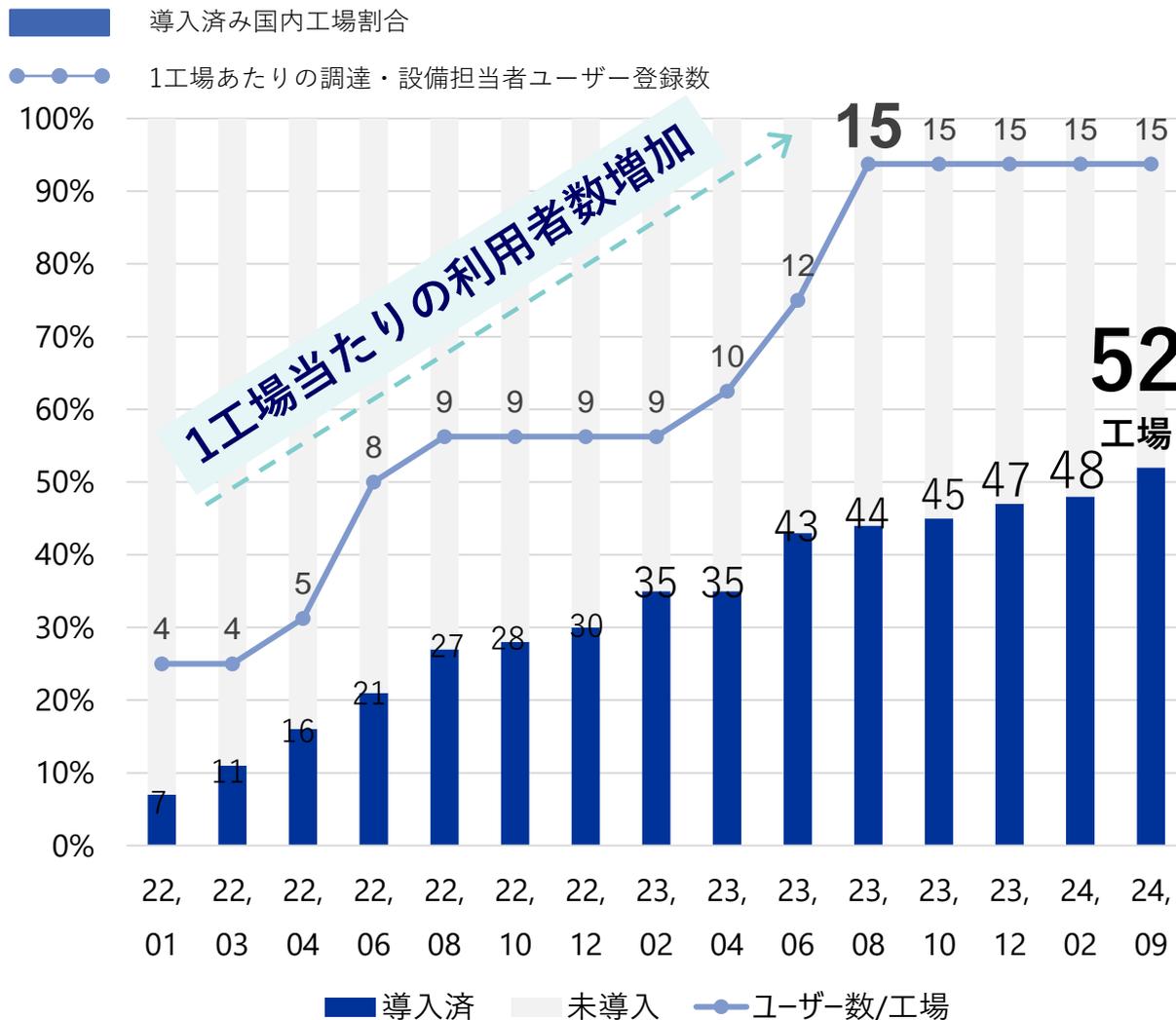
03 | vs 新規参入

- 半導体製造領域は技術的な知見を必要とし、また既に日本全国に顧客基盤があり多くのシェアを獲得していることから、参入障壁を高く保持することが可能

①×②急速に拡大する強固な顧客基盤

国内半導体工場へのLAYLA-ECの導入が加速し、多数の調達・設備専門家が登録

国内半導体工場登録数・国内半導体工場ユーザー登録数推移



国内登録工場数(2024 9月末) :
52工場/約100
 (導入率50%超)

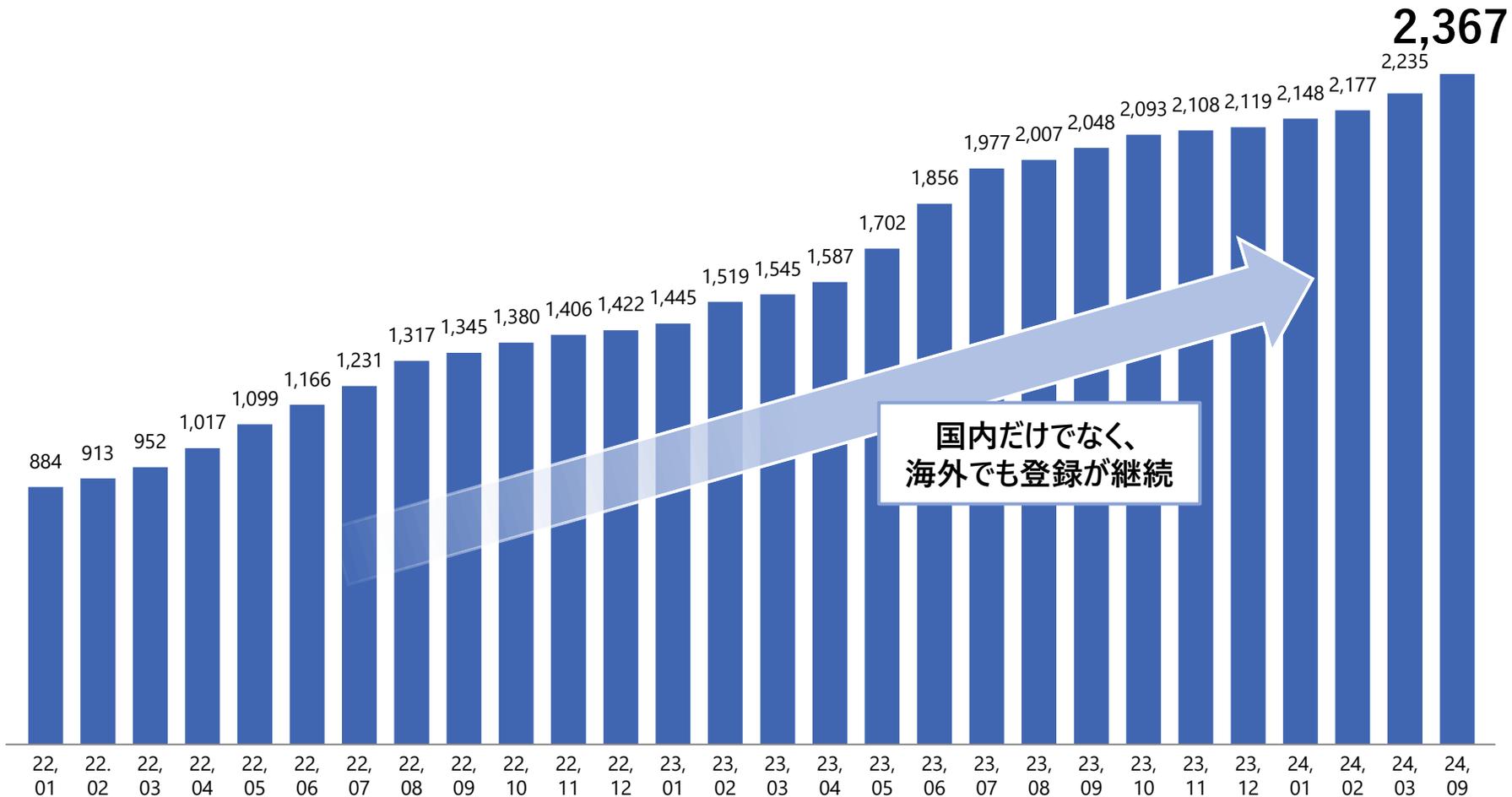
商品点数(2024 9月末) :
31.5万点超

1工場あたりの調達・設備担当
 ユーザー数(2023 8月末) :
15人/工場

国内登録工場数は工場数を意味しております。そのため、同じメーカーでも、工場拠点が異なればそれぞれ別でカウントしております。

①×②継続的に成長するLAYLA-ECのグローバルユーザー LAYLA-ECのグローバルユーザー数も安定的に拡大

グローバルユーザー登録数推移



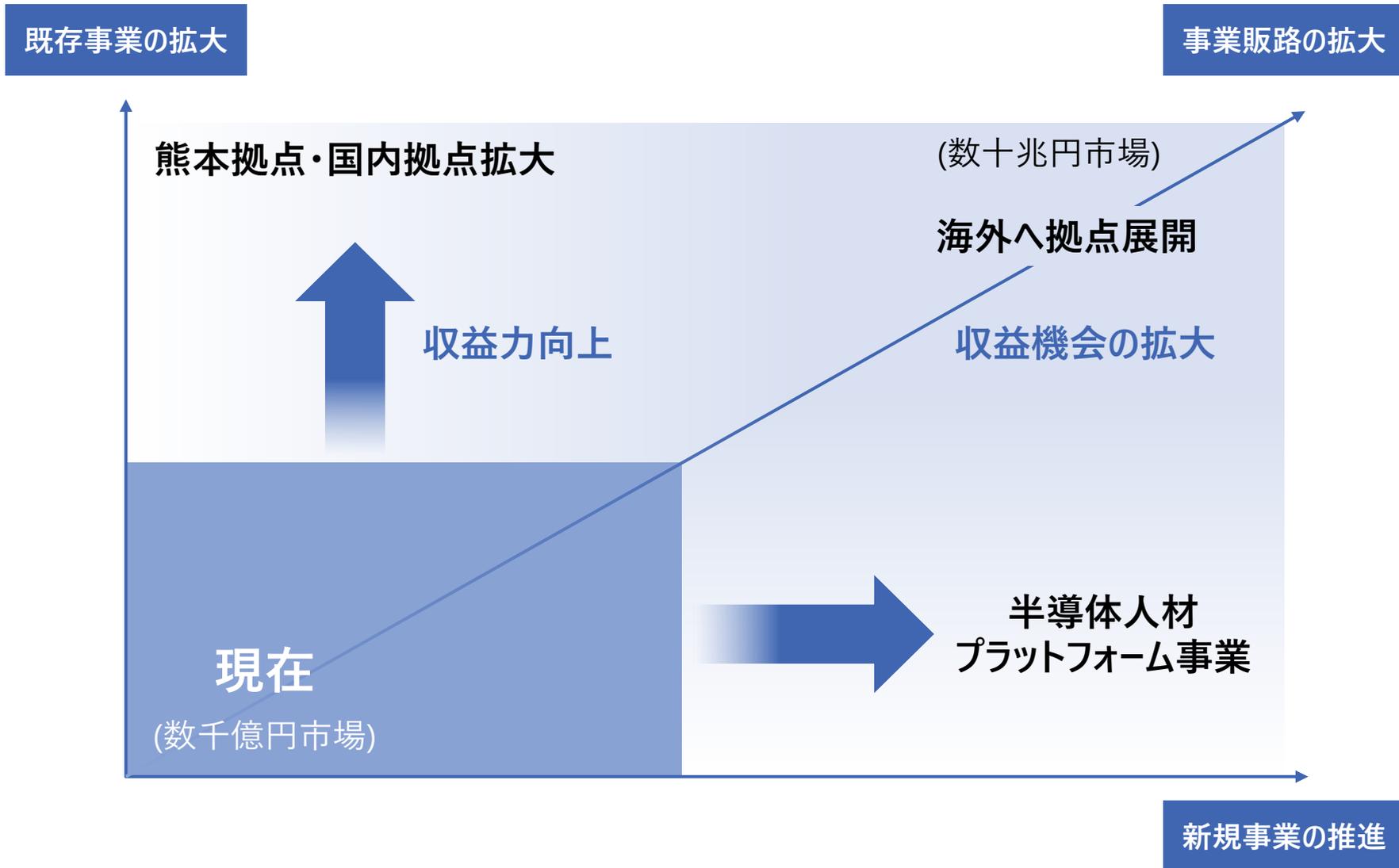
国内だけでなく、
海外でも登録が継続

グローバルユーザーとは、LAYLAに登録されている国内・海外全ての購入者・販売者の合計数

05 成長戦略

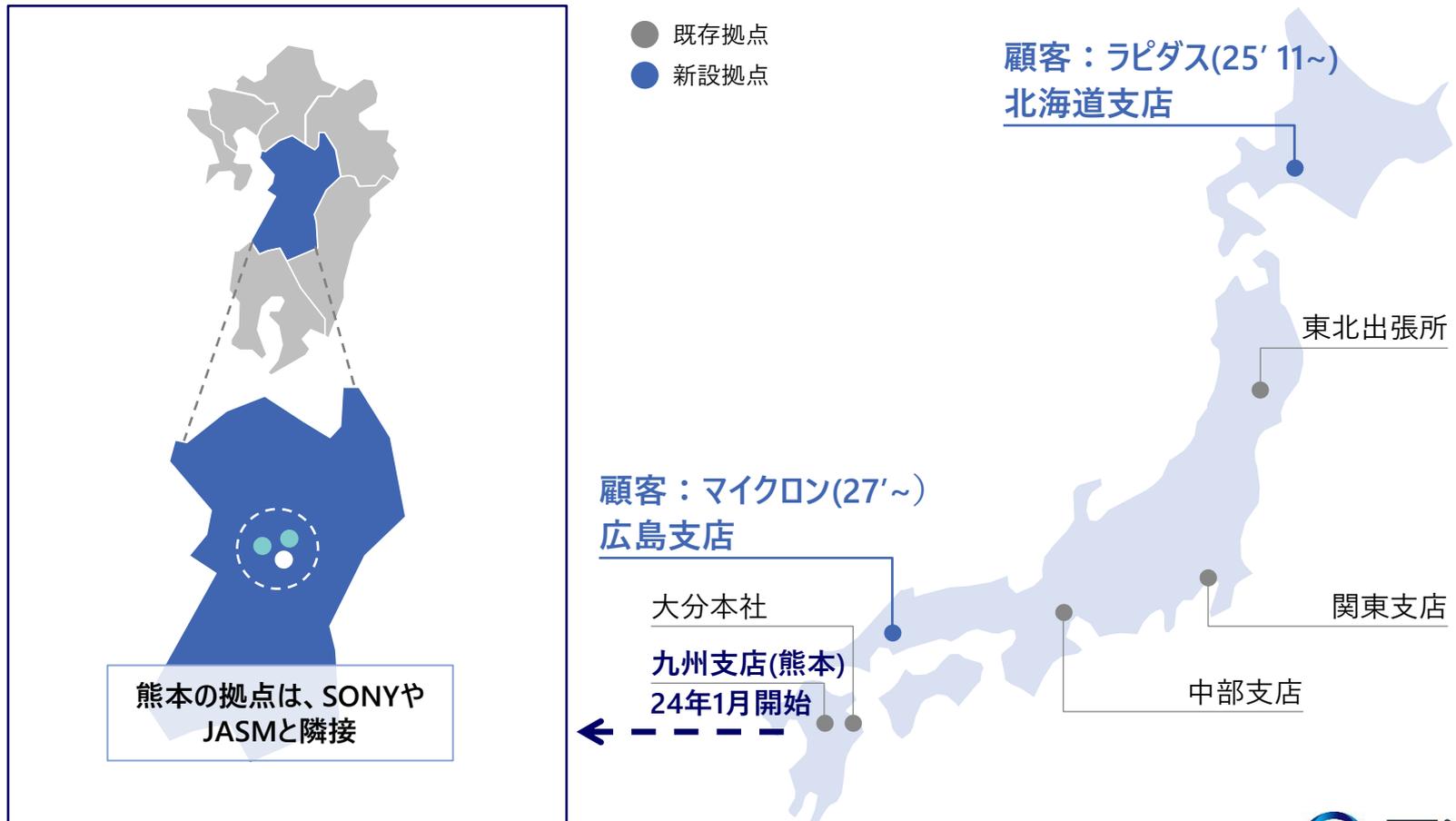
成長戦略イメージ

中長期的には、新規拠点設置、PF拡張、海外展開を視野に入れ事業拡大を狙う



①既存事業の拡大 ～更なる国内拠点の拡大可能性～
広島、宮城、北海道など新たな半導体工場建設が加速

日本国内に大規模投資が行われるなか、
当社は重要顧客に隣接したエリアに営業拠点を設け市場拡大を狙う！

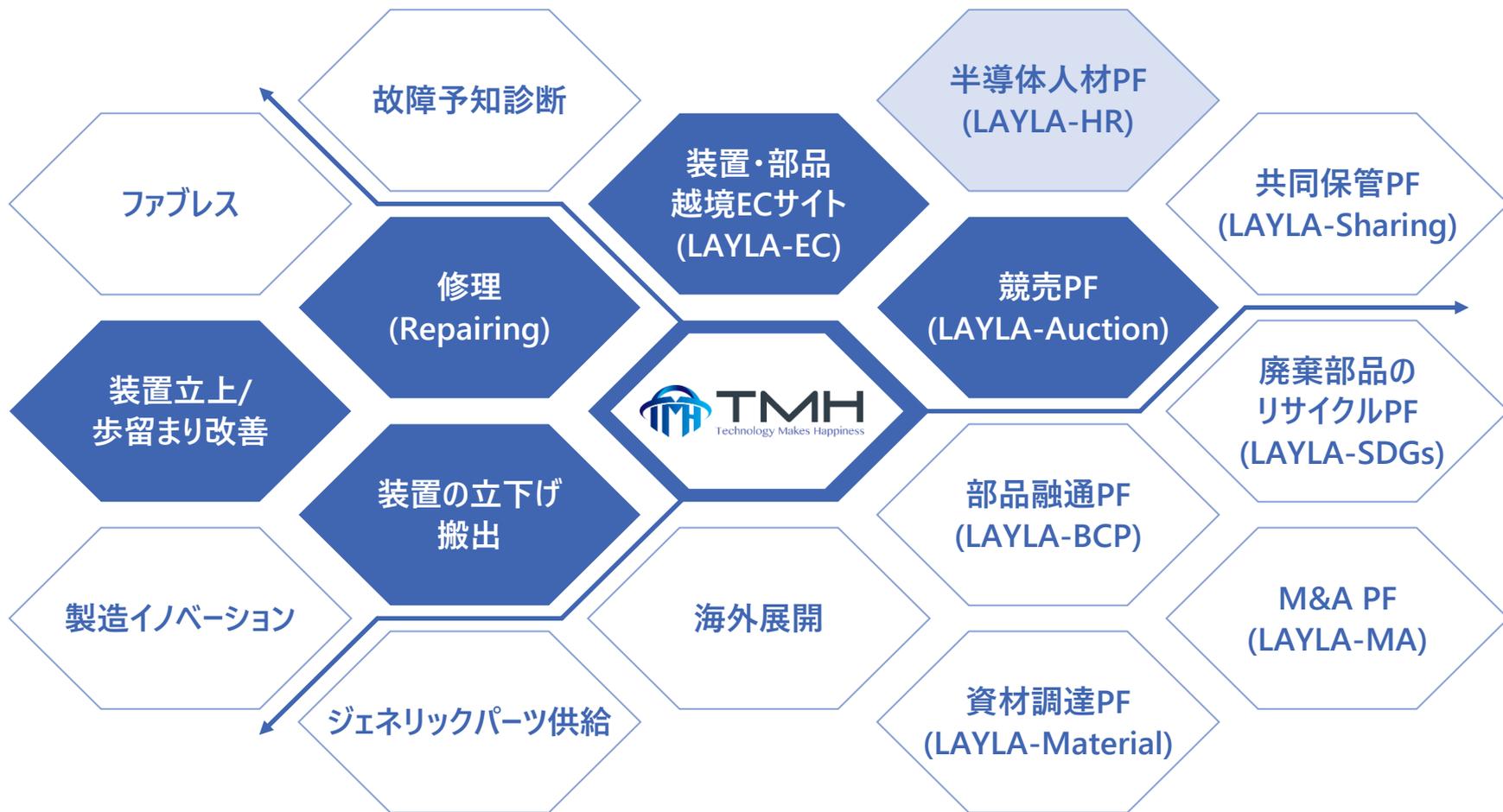


②新規事業の推進 ～当社が目指す成長イメージ～

半導体製造にかかわる課題解決・革新を続ける企業として成長投資を継続

エンジニアリングの拡張

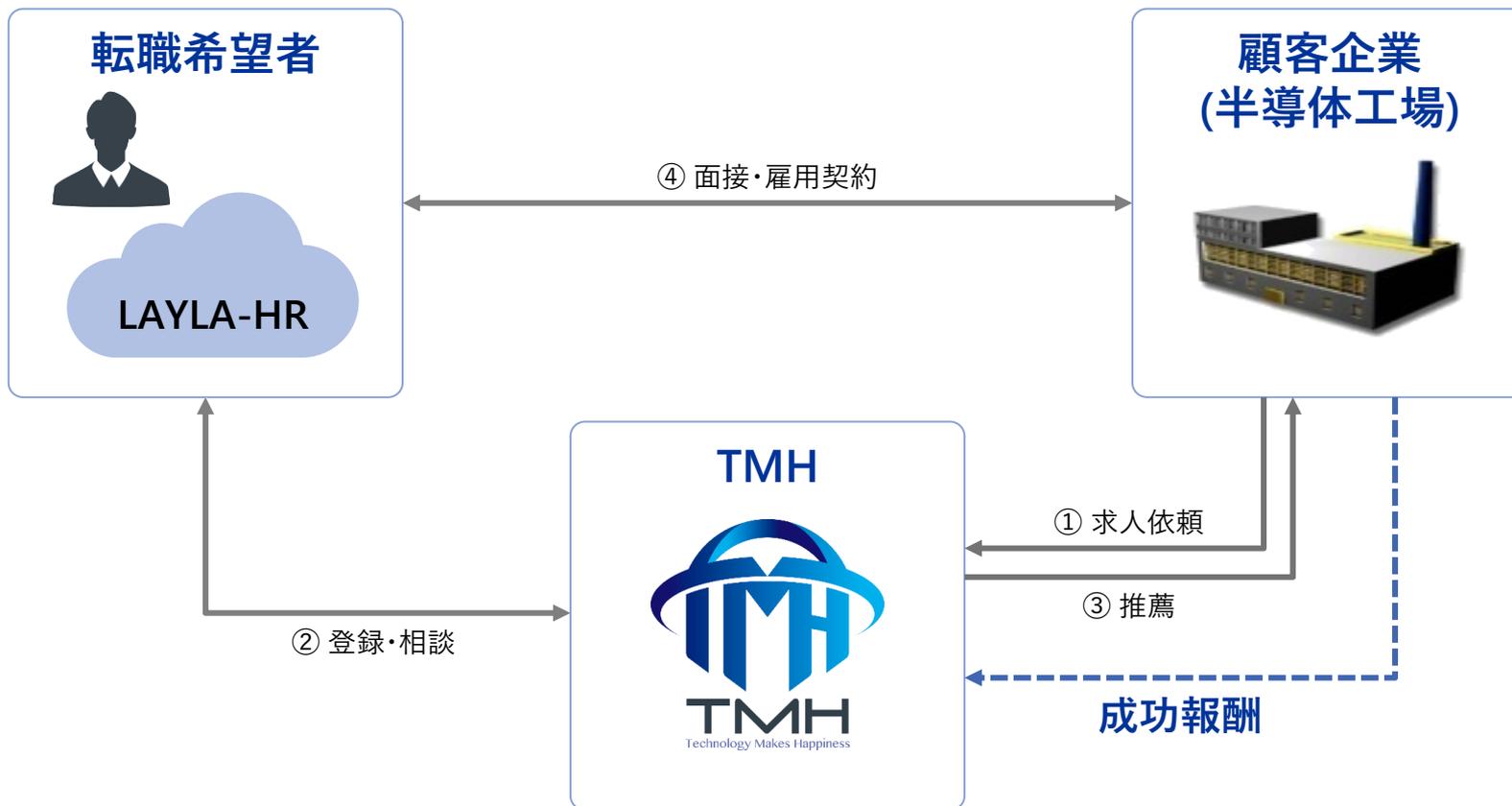
プラットフォームの拡張



②半導体人材PF ～LAYLA-HR～

半導体人材のプラットフォームを構築し、専門型・特化型の人材紹介サービスを開始

新規事業構想(人材紹介サービス)



2025年11月期開始予定

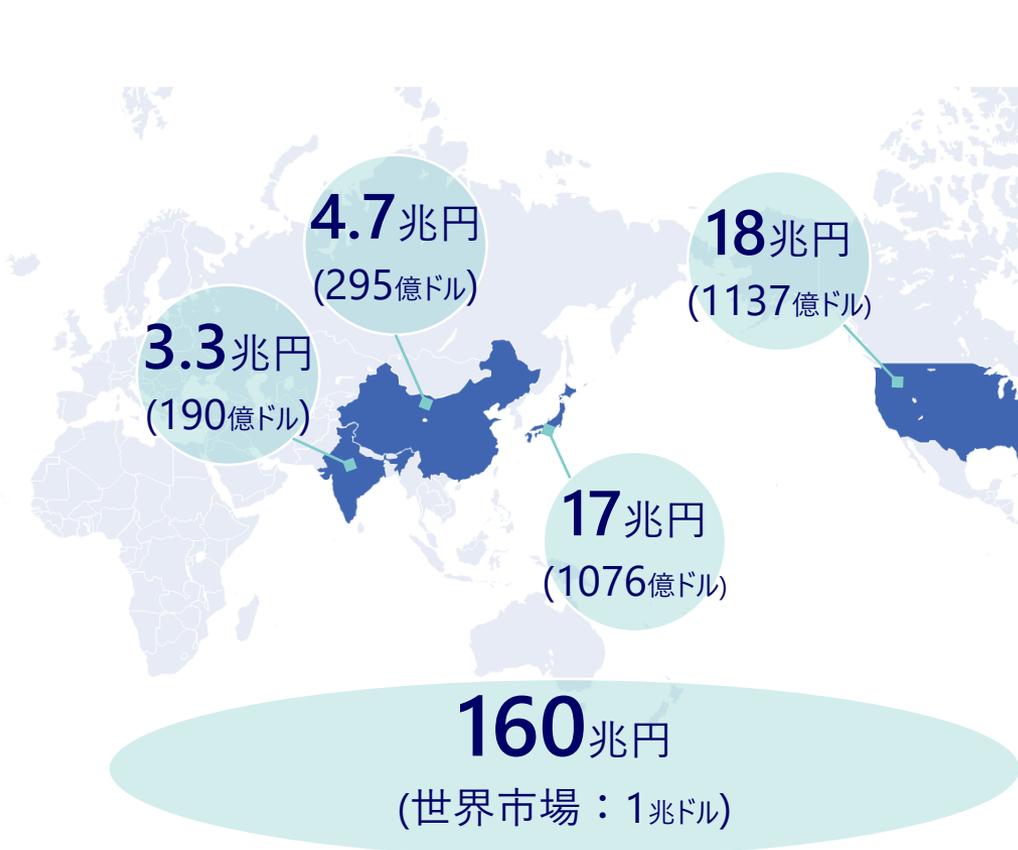
③事業販路の拡大 ～中長期計画 海外展開～

装置延命のトータルソリューションノウハウを活かし、海外展開し売上拡大を図る

国内のトータルソリューションにより培ったノウハウを、海外に展開 2025年の海外進出を皮切りに、世界規模での躍進を目指す

2030年の半導体事業規模

海外展開ポテンシャル



インド

インドの半導体市場は政府と民間企業の協力による投資が進行中で、大きな成長を遂げている。投資する技術レベルからも中古装置購入やメンテナンス需要が拡大が見込まれる

米国

多くの米国企業が製造をアジアにアウトソーシングしているため、国内の製造能力や技術力の維持・強化が課題

台湾

世界的な半導体製造のリーダーとしての地位を維持するための競争が激しく、旧世代の工場も効率的な運用が必要

中国

中国は半導体の技術進化に取り組んでおり、最先端技術の追求と共に旧世代の技術や装置を用いる工場への投資継続

韓国

DRAMやNANDフラッシュなどの特定の製品に特化しているため最先端装置が中心。装置売却ニーズは恒常的に発生

欧州

他の地域に比べて最先端の半導体技術の研究開発が遅れており、旧世代の工場に依存する部分が多い

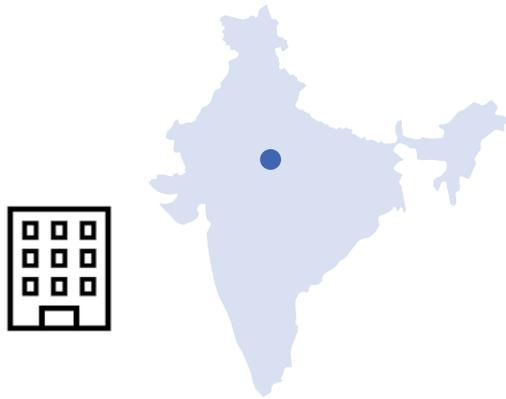
(出所) World Semiconductor Trade Statistics / 世界半導体市場統計

③事業販路の拡大 ～中長期計画 海外展開の方向性～

台湾・インドを中心とした海外展開を成長ドライバーとし、柱に事業を強固なものとする

インド市場を **重点営業強化** エリアとして設定

ECを活用した部品販売や修理サービスから、装置販売先の顧客開拓までを日本と連携し対応



潜在力

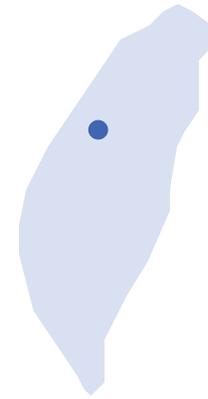
インドは国策として積極的に半導体製造工場の投資を実施、タタGrと台湾のパワーチップ（PSMC）共同による半導体ファブ建設予定もあり、旧型装置やメンテナンス需要も高い

戦略

2024年にインド顧客開拓を実施。セミコンインディアの出展を皮切りに市場拡大を狙う。中長期的には海外営業拠点の一つとして検討

台湾優良サプライヤーと協業し、台湾と **技術連携** を強化

リファブやメンテナンスレベルを昇華、技術力を柱に国内の半導体市場（特に熊本）の拡大を狙う



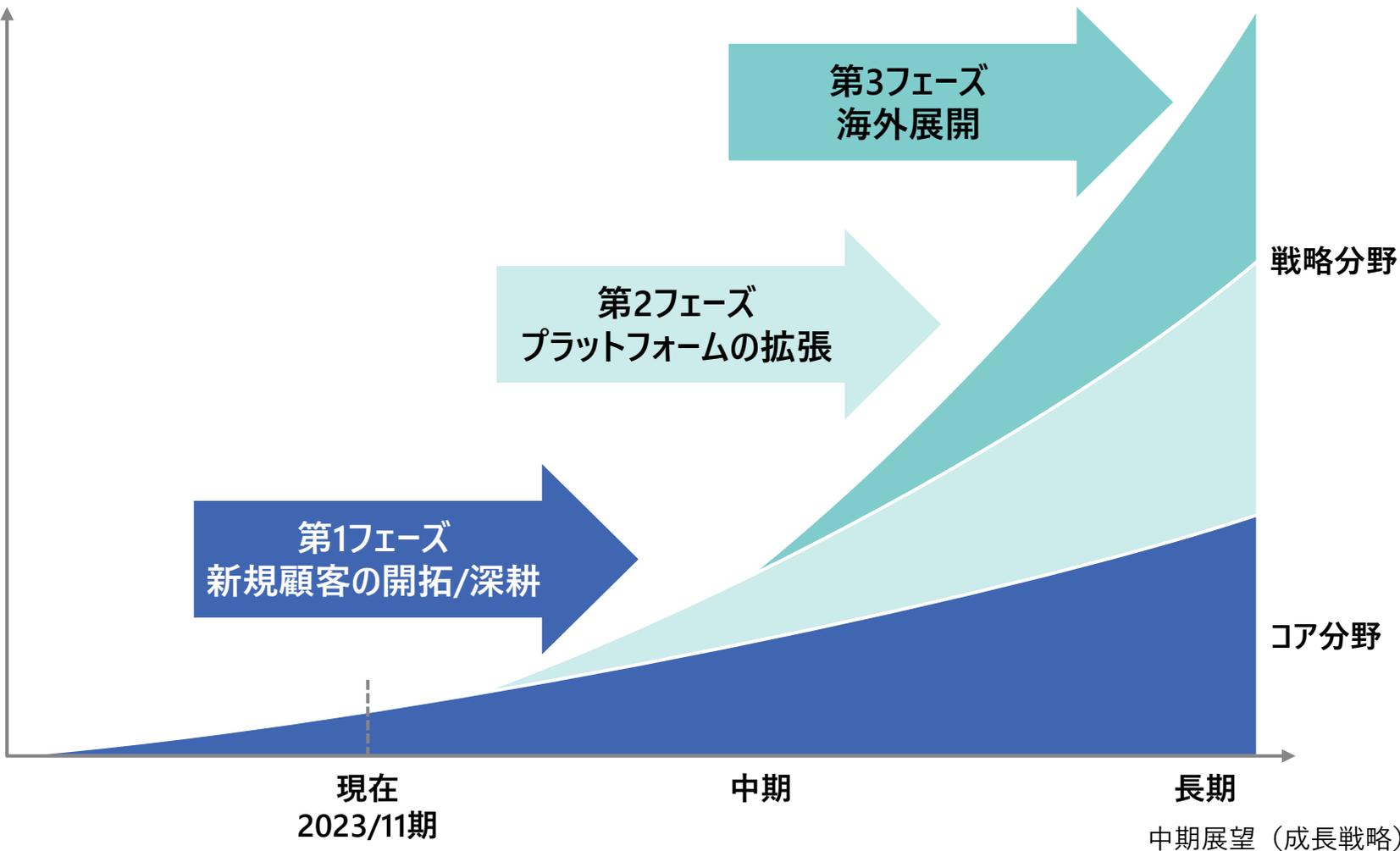
TSMCは日本国内に5つの工場建設を計画・検討、熊本で第1・第2工場の建設は確定。熊本TSMC（JASM）では、サプライヤーの50%を国内調達化する方針であり、参入余地がある

JASMをターゲットとし日本進出を目指すサプライヤー各社と技術連携し、当社の熊本拠点を要の営業拠点とし、営業攻勢を展開

成長イメージ

トータルソリューションの質の拡大、海外への領域拡大により著しい売上拡大が見込める

売上構成のイメージ



中期的なマージンターゲット

新規事業、販路拡大により事業規模を拡大させながら、利益率向上を目指す

ターゲット達成のシナリオ

- 装置販売はシェア拡大を図りつつ、アフターサービスで付加価値を高め、利益率を向上させる
- 部品販売や修理サービス（内製化含む）展開により、利益率の大幅な改善
- 新規事業の人材紹介サービスは高い粗利率を持ち、マッチングプラットフォームよりさらに利益率が向上

売上総利益率目標

25%

マージン拡大のための施策

- これまでの実績に基づくさらなる大型案件の受注
- プラットフォーム等を利用した部品販売・修理サービスや人材紹介サービスの事業成長により収益性が向上

営業利益率目標

15%

マージン拡大のための施策

- 案件が大型化することで、売上全体に占める販管費率低下
- 大規模工場の近隣に拠点を展開し、ソリューション営業を展開することにより、収益性の高いビジネスを実現するとともに、効率化を追求することで成長期においても経費削減を実現

06 リスクと資金使途

事業上のリスクと対応策（1/2）

項目	事業等のリスクの概要	可能性	影響度	顕在化時期	対応策
マクロ経済環境について	半導体は様々な製品に使用されますが、景気や技術革新によって需要が変動します。また、当社ビジネスの商流には、輸入や海外半導体製造工場への輸出も含まれています。そのため、当社の業績は景気、経済動向、技術革新、地政学的リスクによる影響を受ける可能性があります。	中	中	短期～長期	リスクコンプライアンス委員会において対処すべきリスクを検討の上、取締役会へ報告する体制を整備しています。また、かかるリスクの発現の兆候を早いタイミングで察知すべく、市場動向や競合状況の調査・分析を行い、顧客との対話を通じたニーズの把握に努めています。
為替変動について	台湾や韓国、米国などの海外から部品等を輸入しています。当社が輸入において使用する外貨（主に米ドル）が円安に転じた場合、仕入コストの上昇に繋がる可能性があります	中	中	特定時期なし	為替変動による仕入れコストの上昇を、販売価格に転嫁するよう努めています。また、輸入取引に関連して、契約時の前払等を活用した為替リスクのヘッジに継続的に取り組んでおります。
主要顧客への依存について	寡占の進む半導体業界は、大手による市場シェアが高い環境となっています。かかる環境を背景に、当社の売上高は、大手半導体メーカー向けの割合が比較的大きく、大手半導体メーカーの投資動向の影響を受けやすい傾向にあります。	中	中	特定時期なし	きめ細かい顧客との対話を通じて、主要顧客各社の動向の把握に努めるとともに、新規顧客の開拓を進めて参ります。

事業上のリスクと対応策（2/2）

項目	事業等のリスクの概要	可能性	影響度	顕在化時期	対応策
調達について	特に装置販売ビジネスにおいては、新たな設備投資を先行させる特定の大手半導体メーカーからの、中古装置・部品の調達が多い状況です。したがって、何らかの理由により仕入先からの供給の停止が生じた場合、当社による調達が停滞する可能性があります。	小	中	特定時期なし	200社を超える世界中のサプライヤーと関係を構築しています。またこれらのサプライヤーの有する在庫情報を常時収集し、顧客ニーズへの柔軟な対応を可能とすべく幅広い調達先を確保し、特定サプライヤーへの依存を下げるよう努めています。
人材の確保および育成について	地方に本社を構えることに起因する採用競争力への影響が生じる場合や、人材の育成・定着が計画どおり進まない場合には、事業拡大の制約となる可能性があります。	中	大	特定時期なし	継続的に有能な人材の確保に努めるとともに、人材の育成・定着に資する会社のカルチャー醸成・その浸透、また人事制度や職場環境の更なる改善を図ってまいります。

上記には、当社が経営においてリスク要因となる可能性があると考える主な事項について記載しています。有価証券届出書「事業等のリスク」に記載の内容のうち、成長の実現や事業計画の遂行に影響する主要なリスクを抜粋して記載しています。その他のリスクは、有価証券届出書の「事業等のリスク」をご参照ください。

資金使途

上場時における調達予定資金（予定金額3.76億円）の使途内訳は以下の通り

- 国内外での半導体投資が急速に加速するなかで、2024年は当社が事業を拡大する最善な時期。信用力を高め、顧客拡大と優秀な人材の確保を実現
- 調達した資金は、国内外の拠点拡大や新たなプラットフォーム構築、人材採用及び設備投資に重点的に活用予定

単位：千円

項目	予定金額	使途予定金額	
		2025年11月期	2026年11月期以降
広告宣伝費	4,000	4,000	-
中部支店 設備投資	20,000	20,000	-
LAYLA等のシステム開発費用	81,000	31,000	50,000
採用費用および人件費	271,366	100,000	171,366
合計	376,366	155,000	221,366

Disclaimer

免責事項

本資料は、当社の業界動向及び事業内容について、現時点における予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来展望についても言及しております。

これらの将来展望に関する表明の中には、様々なリスクや不確実性が内在します。既に知られたもしくは未だに知られていないリスク、不確実性その他の要因が、将来の展望に関する表明に含まれる内容と異なる結果を引き起こす可能性がございます。

当社の実際の将来における事業内容や業績等は、本資料に記載されている将来展望と異なる場合がございます。

本資料における将来展望に関する表明は、2024年11月現在において利用可能な情報に基づいて当社によりなされたものであり、当社として将来の結果や業績を保証するものではないことにご留意ください。

成長可能性資料の次回開示（更新）は、2025年2月末日までの公表を予定しております。